

Dosierung von 1K-Acrylatklebstoff

Kategorie: [Anlagen & Komponenten](#)

Erschienen am: 24. Dezember 2018

Auf Bauteile aufgetragene Dichtstoffe dienen in erster Linie dem Schutz sensibler Komponenten. Sie schützen vor äußeren Einflüssen wie Staub oder Feuchtigkeit. Durch den Einsatz von Dicht- und Klebstoffen ist aufgrund der zusätzlichen Fügeverbindung eine multifunktionale Verbindung möglich – im Gegensatz zu klassischen vorkonfektionierten Dichtungen. Eine präzise Überlappung von Anfang und Ende der geschlossenen Dichtraupe ist hierbei essentiell, um eine homogene Kraftübertragung sowie die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten. ViscoTec Dispenser haben sich in zahlreichen Dosiertests und Anwendungsfällen für die Auftragung der hochviskosen Materialien bewährt.

In der industriellen Fertigung wird zwischen zwei Verfahren zur Applikation von Flüssigdichtungen unterschieden: Dem CIPG- und dem FIPG-Verfahren. Im Falle des "cured-in-place gasket" Verfahrens erfolgt die Weiterverarbeitung des Bauteils erst nach Aushärtung des Dichtmittels. Bei "formed-in-place gasket" Verfahren hingegen wird das Bauteil mit der noch nicht vernetzten Flüssigdichtung gefügt und weiterverarbeitet. Ein Dichtmittel, das perfekt für beide Verfahren geeignet ist, ist der hochviskose und standfeste 1K UV- und lichthärtende Acrylatklebstoff Photobond SL4165 von Delo.

Um die Dichtheit der Dosierraupe zu gewährleisten, muss der Materialauftrag entlang der Dichtkontur präzise und wiederholgenau erfolgen. Mit den ViscoTec-Dispensern können trotz unterschiedlicher Dosiergeschwindigkeiten auch komplexe Geometrien problemlos dosiert werden. Der programmierbare Rückzug dient außerdem dazu, ein Nachtropfen und die Verschmutzung des Bauteils bzw. der Dichtung zu vermeiden. Ferner können durch die Möglichkeit der endlosen Dosierung auf einfache Weise unterschiedliche Dichtungsgrößen und Formen realisiert und die Fertigung ohne großen Aufwand angepasst werden.

Der 1K-Acrylatklebstoff findet seinen Einsatz beispielsweise in der Elektro- und Elektronikindustrie, im Bereich der E-Mobility und in der Automobilbranche. In Anwendungen wie der Abdichtung von Gehäusen, Motoren, Getrieben und Sensoren wird das klassische Dichtverfahren zunehmend von der Abdichtung mit zusätzlicher Klebefunktion abgelöst. Diese Entwicklung bringt klare Vorteile mit sich: Der Anwender ist in der Formgebung der Dichtraupe flexibler, die Kosten für die Lagerung sowie der Zeitaufwand für die Montage entfallen.